

「ネプコンジャパン2014」に出展致します

— 会期:2014年1月15日(水)~1月17日(金) 会場:東京ビッグサイト —

是非、弊社ブースへお立ち寄りください [東30-21]

弊社はおかげさまで創業90周年を迎え、創業精神である新製品開発に日夜邁進しております。
この度2014年1月15日(水)~2014年1月17日(金)に開催されます「ネプコンジャパン2014」に出展の運びとなりました。

出展品は不透明材料にも接着が可能な UV 硬化形弾性接着剤SX-UVシリーズ。防水・リペアが可能なBBX100シリーズをはじめ、現在開発中の新製品なども多数出品いたします。

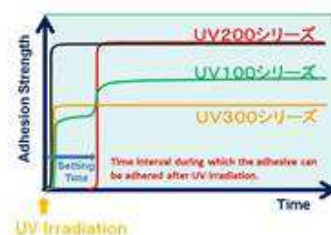
ご多用とは存じますが、同封の展示会招待券にてご来場いただき、弊社製品・技術・サービスをご高閲賜りたく、ご案内申し上げます。

<出展内容>

- 1) UV硬化形弾性接着剤 セメダインSX-UVシリーズ (H26.春発売予定)

当社初のUV硬化形弾性粘接着剤シリーズ

不透明材料も接着できる画期的なUV粘接着剤で、硬化後はフレキシブルな弾性接着剤となり、異種材料の接着に最適です。



- 2) リペアラブル液状粘着剤 BBX100シリーズ (開発試作品)

まるで接着剤のように塗布直後に貼り合せ可能で、硬化後はノリ残りせず容易に手ではがせ、防水性と耐衝撃性を持つリペアラブルシール材です。



- 3) UV湿気硬化形防湿コーティング剤 (参考出展)

柔軟性に富み優れた防湿性を示すため、機能性ガラスまわりの小口(端面)封止に最適です。

小口(端面)に塗布する装置のノウハウもご提供できます。



- 4) UV硬化形液状ガスケット UV-CIPG (参考出展)

UVによる速硬化、工程の短縮を実現可能にする液状ガスケットとして優れた作業性・圧縮永久歪特性を持ち使用可能です。



皆様のご来場を心よりお待ちしております。